

## COMUNICATO STAMPA

### Capital Market Day 2025: Technoprobe presenta le linee strategiche della crescita futura e conferma il suo ruolo di leader nel segmento del testing dei semiconduttori

**Cernusco Lombardone (LC), 14 Aprile 2025** –Technoprobe S.p.A., società quotata su *Euronext Milan* e leader nella progettazione e produzione di probe card (la “Società” o “Technoprobe”) presenta oggi in un evento dedicato i driver di crescita e le linee strategiche volte a consolidare il proprio posizionamento nel segmento del testing dei semiconduttori.

La gestione della crescente complessità correlata all’evoluzione tecnologica rappresenta la sfida del futuro che Technoprobe, forte del know-how tecnologico sviluppato internamente e ulteriormente rafforzato dalle partnership siglate con **Teradyne** ed **Advantest**, affronterà attraverso soluzioni di testing avanzate e capaci di rispondere alle esigenze dei propri clienti sia a livello **front-end** che **back-end** del processo produttivo dei semiconduttori.

Il consolidamento della leadership nel segmento del testing resta l’obiettivo primario della Società e sarà declinato nel **front-end** attraverso le seguenti azioni:

- **Rafforzare il ruolo apicale nel testing dei chip logici**, con particolare focus sullo sviluppo di soluzioni specifiche per le architetture *Advanced Packaging*, il cui sviluppo ha registrato una accelerazione con l’introduzione dell’intelligenza artificiale;
- **Ampliare l’offerta di soluzioni di high-speed, high-voltage, radio frequency e silicon photonics**: l’incremento del volume di dati da processare ed al contempo la velocità delle interconnessioni tra diverse tipologie di device sosterranno la crescita dei volumi di tale tipologia di prodotti;
- **Espandere la propria presenza anche nel testing dei chip di memoria** con l’ingresso nel segmento **High Bandwidth Memory**, oggi elemento fondamentale dei chip di intelligenza artificiale.

A livello **back-end**, le sinergie create tra Technoprobe e DisTech, permetteranno di incrementare la penetrazione del segmento Device Interface Board attraverso lo sviluppo di una nuova architettura avanzata, **FusionLink**, capace di agevolare lo sviluppo di Printed Circuit Boards (PCB) evoluti.

Le linee strategiche delineate si inseriscono in un contesto geo-politico particolarmente complesso, caratterizzato da forte instabilità nelle politiche commerciali globali. Alla luce di tale scenario, la Società illustrerà nel corso dell’evento il target model di medio periodo.

Stefano Felici, Amministratore Delegato di Technoprobe, ha dichiarato: “*Il percorso di crescita che Technoprobe ha conseguito fino ad oggi le ha permesso di raggiungere una leadership che ci impegniamo a mantenere nel futuro.*”



Technoprobe S.p.A.  
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2  
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italy  
[www.technoprobe.com](http://www.technoprobe.com)

*La nostra capacità di rispondere tempestivamente alle sfide che il progresso tecnologico ci sottopone è supportata dalla solidità finanziaria della Società che ci garantisce le risorse necessarie a sostenere la ricerca, pilastro della crescita.*

*Siamo focalizzati sullo sviluppo di soluzioni di testing più complesse e, forti del nostro know-how, sulla sfida più impegnativa dei prossimi anni: entrare in uno dei segmenti delle memorie a più alto potenziale di sviluppo. L'instabilità dell'attuale scenario economico e politico ci impone una costante attenzione alla marginalità che, ad oggi, è prevista nel medio termine in progressiva crescita."*

### **Informazioni aggiuntive**

Ulteriori dettagli verranno forniti oggi durante la presentazione che si terrà presso Villa Gallarati Scotti a Oreno a partire dalle 14:00 CET.

L'agenda ed il live streaming dell'evento sono disponibili sul sito Technoprobe all'indirizzo [www.technoprobe.com/capital-market-day-2025](http://www.technoprobe.com/capital-market-day-2025).

\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* di Technoprobe [www.technoprobe.com](http://www.technoprobe.com) nella sezione "Investor Relations" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

\*\*\*

### **Contatti**

**Technoprobe S.p.A.**  
Investor Relator  
Ines Di Terlizzi  
Email: [ir@technoprobe.com](mailto:ir@technoprobe.com)

**Technoprobe S.p.A.**  
Communication & Marketing Manager  
Paolo Cavallotti  
Email: [paolo.cavallotti@technoprobe.com](mailto:paolo.cavallotti@technoprobe.com)

### **Gruppo Technoprobe**

Technoprobe è un'azienda leader nel settore dei semiconduttori e della microelettronica. Costituita nel 1996, Technoprobe è specializzata nella progettazione e realizzazione di interfacce elettro-meccaniche denominate Probe Card (schede sonda) per il test di funzionamento dei chip. Le Probe Cards sono dispositivi ad alta tecnologia - fatti su misura sullo specifico chip - che consentono di testare il funzionamento dei chip durante il loro processo di costruzione. Si tratta di progetti e soluzioni tecnologiche che garantiscono il funzionamento e l'affidabilità dei dispositivi che hanno un ruolo determinante nell'industria dell'Information Technology, del 5G, dell'Internet of Things, della domotica, dell'automotive, dell'aerospaziale. Technoprobe ha il suo headquarter in Italia, a Cernusco Lombardone (LC). Dal 2 maggio 2023, Technoprobe è quotata sul mercato Euronext Milan. Per maggiori informazioni: [www.technoprobe.com](http://www.technoprobe.com)